

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月1日(01.05.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/089266 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/50 (2006.01) *C09J 163/00* (2006.01)
C09J 9/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/037545

(22) 国際出願日: 2024年10月22日(22.10.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-181725 2023年10月23日(23.10.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド(**THREEBOND CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 (JP).

(72) 発明者: 遠藤 悟(**ENDO, Satoru**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 (JP).

(74) 代理人: I B C 一番町弁理士法人(**IBC**); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: ELECTROCONDUCTIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 導電性樹脂組成物

(57) Abstract: The present invention provides an electroconductive resin composition which, even when cured at a low temperature such as about 80°C, can give cured objects excellent in terms of adhesive force and electroconductivity. The electroconductive resin composition comprises the following (A) to (C) components, wherein the (C) component comprises (C-1) and (C-2): (A) component, an epoxy resin; (B) component, electroconductive particles; and (C) component, polyamine-based latent hardeners comprising (C-1) a polyamine-based latent hardener having a softening point of 50-129°C and (C-2) a polyamine-based latent hardener having a softening point of 130-180°C.

(57) 要約: 本発明は、80°C程度のような低温での硬化においても、接着力と導電性に優れた硬化物を得られる導電性樹脂組成物を提供する。下記の(A)~(C)成分を含み、(C)成分が(C-1)および(C-2)を含む、導電性樹脂組成物である: (A)成分: エポキシ樹脂 (B)成分: 導電性粒子 (C)成分: ポリアミン系潜在性硬化剤 (C-1): 軟化点が50~129°Cであるポリアミン系潜在性硬化剤 (C-2): 軟化点が130~180°Cであるポリアミン系潜在性硬化剤。



WO 2025/089266 A1